

京东方科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-046

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他_____
参与单位名称	平安资管：胡宇舟、李惠 财通证券：王硕 西部证券：张昕洁
时间	2026 年 10 月 13 日
地点	京东方技术创新中心
上市公司接待人员姓名	罗文捷 证券事务代表 吴易霖 董事会秘书室工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	讨论的主要内容为回答投资者提问，问答情况如下： 1、如何看待近期面板厂的涨价行为？ 答：近期，受上游原材料价格变动及全球产业链供需变化影响，公司部分关键物料采购成本持续上行，供应链成本压力持续加大。公司结合自身成本、产品及具体交易情况制定价格政策，已就部分产品的价格事项与相关客户开展沟通，具体交易价格按照双方合同约定及协商结果确定，以保障产品品质与长期稳定供货，并确保后续技术迭代与服务能力持续提升。 2、近期 OLED 行业情况？ 答：在存储产品涨价的背景下，下游终端产品涨价逐渐传导到消费端，根据咨询机构分析和预测，2026 年下半年柔性 AMOLED 需求承压明显，行业面临量、价双降的局面。在此背景下，公司持续深化与品牌客户的技术合作与定制开发，重点布局 LTPO、折叠等高端产品，持

	续优化客户产品结构，积极应对行业困境。此外，公司第 8.6 代 AMOLED 生产线自量产以来，正按计划稳步推进产能爬坡和良率提升，以对应客户高端中尺寸显示产品需求。 3、公司玻璃基先进封装业务布局及进展？ 答：公司目前已实现高深宽比 TGV 开孔、深孔填铜、低应力金属布线、高层数压合、高密度布线、低应力切割等玻璃基封装载板全流程工艺拉通，拥有完备玻璃基封装载板制造工艺能力。目前，公司试验线已实现全自动化设备通线，已有超过 100×100mm 尺寸的 24 层（11-2-11）玻璃基封装载板产出并送样，且现已通过 Pre-con、TCB 1000 cycles、UHAST、BHAST、HTSL、LTSL 信赖性标准测试。 4、公司目前光互连项目进展？ 答：公司已成立 Micro LED 光互连系统及玻璃载板 CPO 技术攻关项目组，和生态伙伴进行前瞻技术预研，加快技术攻关。 5、公司少数股东股权的回购计划？ 答：公司控股子公司合肥京东方显示技术有限公司于 2026 年 7 月完成了少数股东定向减资，注册资本由 240 亿元减少至 175.5 亿元，公司在该子公司持股比例从 36.67%提高至 50.14%。本次减资是继 2025 年完成武汉 10.5 代线定向减资后，公司再次以自有资金完成 10.5 代线少数股权定向减资。通过定向减资，公司能够在保持财务结构稳健的同时，进一步提高归母净利润比例，这将有助于增厚上市公司股东收益。后续公司将根据经营状况和现金流情况，择机回购少数股东股权，具体进展请关注公司或有权机构公告。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单	无
日期	2026 年 10 月 13 日